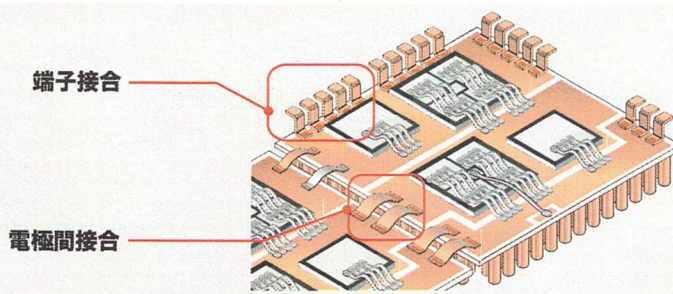


# パワー半導体接合技術

Power semiconductor bonding technologies

Application

Products



端子接合

Terminal bonding



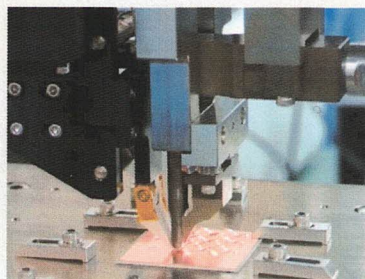
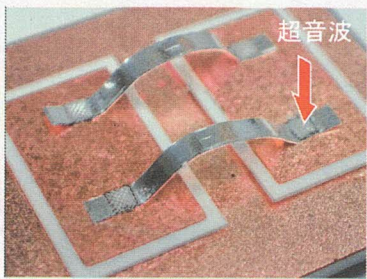
●超音波端子接合装置 BP1000MS  
Ultrasonic terminal bonder



- ・荷重 Load : 50 ~ 1000N
- ・周波数 Frequency : 20/30kHz

電極間接合

Inter-electrode bonding



●リボンボンダ RB300LS  
Ultrasonic ribbon bonder



- ・荷重 Load : 50 ~ 300N
- ・周波数 Frequency : 40kHz
- ・リボンフィーダー切り替え機能  
Ribbon feeder switching function

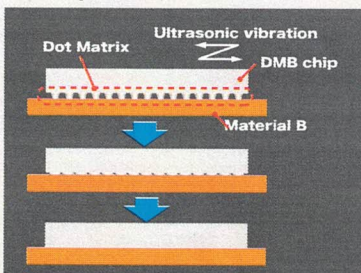
DMB 工法

Dot Matrix Bonding process

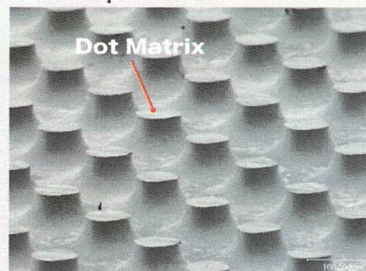
DMB プロセスによって広い面積を接合を可能にします。

The DMB process enables bonding over large areas.

DMB process



DMB chip surface



●超音波接合装置 UB2000LS  
Ultrasonic bonding machine



- ・荷重 Load : 50 ~ 2000N
- ・周波数 Frequency : 20/30kHz



**adwelds**  
advanced welding & bonding Technologies

株式会社アドウェルズ  
福岡 本社  
東京営業所  
名古屋テクニカルセンター

<http://www.adwelds.com> Mail [info@adwelds.com](mailto:info@adwelds.com)

〒811-1201  
〒140-0004  
〒463-0018

福岡県那珂川市片縄 8 丁目 140 番地  
東京都品川区南品川 5 丁目 10 番 45 号  
愛知県名古屋守山区桜坂 4 丁目 206 番地  
なごやサイエンスパーク 先端技術連携リサーチセンター内

TEL 092-555-6000  
TEL 03-6433-9920